# デジタル 欧の販売拠点拡充

## 代理店ルートから直販体制へ

## 蘭現法完全子会社に

デジタルは欧州の販売拠点を拡充する。欧州での販売を統括するオランダの現地法人「プロフェース・ヨーロッパ」（アムステルダム市）の出資比率を67%から100%に増強、完全子会社化した。すでに独、仏でも拠点拡充を進めており、これを機に従来の代理店ルートから直販体制へ比重を高め、欧州での売上高を現在の9億円から2002年度に30億円へ伸ばし、シェア30%の獲得を目指す。

欧州の拠点拡充は主力のプログラマブル表示器やパネルコンピューターの拡販が狙い。オランダの現地法人は33%出資していた守谷商会（東京都）の株式を買い取り、100%子会社化した。

ドイツでは2月にシーアイ・インターシス社を3億円で買収、従業員と販売ルートを引き継ぎ、新会社「プロフェース・ドイツ」（シュツットガルト市）と名称変更したほか、フランスでも6月に欧州法人傘下の販売拠点プロフェース・フランス」（パリ市）を85%出資で立ち上げた。現地で働く人員も総勢24人から45人と増強した。

欧州では10社程度の代理店ルートで主に販売してきたが、これを機に直販体制に比重を移す。また機器の整備や保守点検などの顧客サポートも現地法人が担当できるようサービス体制も整えた。使用する言語も現地語を主体にソフトウエアの開発やセミナーを実施する。欧州ではすでにイタリア、英国、デンマークに販売拠点があり、全6拠点体制で市場開拓する。

同社はプログラマブル表示器で国内シェア45%のトップ企業だが、欧州でも拡販を進め、同地域の市場シェアを現在の4%から02年度までに30%獲得を目指す。

## 通信規格を無償公開

### エコーネットコンソーシアム 家電ネット化用

エコーネットコンソーシアム（野間口有理事長）は26日、家電をネットワーク化するための通信規格「エコーネットバージョン1・0」の規格書を完成、無償で一般公開を始めた。会員企業に対してはすでに公開しており、対応製品の開発は始まっているという。

エコーネットは複数の家電を相互接続し、統一的に管理するための規格。電灯線や無線を利用するため、配線工事が不要となるのが特徴。国内の大手電機メーカーが中心となって97年にコンソーシアムを結成、規格策定を進めていた。

同コンソーシアムではバージョン1・0を完成したことで、今後は機能拡張のほか、ライセンス機関や規格認証機関の設置、国際標準化などにも取り組む。ライセンス料は、普及を図るために2003年3月末まで無償とし、それ以後も安価に抑えたい考え。

## 光ファイバー 古河電工が大幅増産

### 高機能 70億円投じ千葉に新工場

古河電気工業は70億円を投資し、高機能タイプを中心に光ファイバーを大幅に増産する。千葉事業所（千葉県市原市）に新工場を建設し、光部品に使用されるスペシャリティーファイバーと、陸上線路や海底線などで用いられるプレミアムファイバーを増産する。汎用のシングルモードファイバー（SMF）と合わせ、2001年度の上期中に総生産能力を現行の2倍にする。

北米市場を中心に、波長多重伝送（WDM）方式の光通信網の急速な拡大に対応する措置。同時に、プリフォーム（母材）の製造能力も増強していく。

同社では千葉のほか、三重事業所（三重県亀山市）でもファイバーを生産。生産効率を高めるため、現在SMFの生産を千葉から三重に移管、集約している。しかし、SMFだけでなく、高機能ファイバーも不足していることから、千葉に面積3000平方㍍の建物を8月に着工し、需要に応じることにした。

光ファイバーの市場は「作れば何でも売れる状態。能力を2倍にすれば2倍売れるのではないか…」という状況で、当面は年率20%の成長が見込めるとしている。このため、場合によってはさらなる投資の前倒しもありそうだ。

## IBMとザイリンクス

## 次世代ICで協業へ

### PLD使用 ネット機器市場に的

米IBMと米ザイリンクスはプログラマブル・ロジック・デバイス（PLD）を使った次世代ICで協業すると、両社の日本法人が26日、発表した。ザイリンクスのPLDをベースに、IBMの技術を組み込んだ製品を年内にも投入する。IBMはASICの最大手で、ザイリンクスはPLD最大手。どちらも通信関連に強いことから、両社が協力することで急成長するネットワーク機器市場へ攻勢をかけるものと思われる。

今回の提携では、ザイリンクスがIBMから組み込みマイコン「パワーPC」やASICのバス技術「コアコネクト」など機能ブロック（IP）のライセンスを取得、年内にも同IPを組み込んだ製品出荷を始める。それらの製造はIBMがファウンドリー（受託生産）として受け持ち、線幅が0・13㎛や0・1㎛の最先端のプロセス技術を適用する。これにより、IBMのASICとザイリンクスのPLDを同じアーキテクチャーで開発できる。PLDが高集積化するとともに、ASICとの競合が始まっていたが、「プロトタイプや、ハイエンド製品は」PLDベース、量産品はASICでとすみ分けができる」（赤沼真一日本IBMマイクロエレクトロニクスアプリケーション技術部長）としている。

## フラッシュカードで米社と相互ライセンス

### TDK

TDKは26日、米国サンディスク社（本社カリフォルニア州サニーベール）とフラッシュメモリーICおよびフラッシュメモリーカード製品とTDKのフラッシュメモリーカード製品を対象にしたパテントクロスライセンス契約を締結したと発表した。

契約ではサンディスクが保有するフラッシュカード製品の設計、生産に必要なすべてのパテントライセンスをTDKに供与する。また、TDKが保有するフラッシュメモリー関連ICおよびカード製品の設計、生産に必要なすべてのパテントライセンスをサンディスクに供与する。

今契約の締結によって2社はフラッシュメモリーカード製品分野に関する全世界的な生産、販売権を相互に保有することになる。

## 厚木事業所内にR&D館を完成

### アンリツ

アンリツは、開発・生産の主力拠点である厚木事業所（神奈川県厚木市）内にR&D館を完成させた。延べ床面積は1万3000平方㍍。1期工事の大型電波暗室設備は昨年10月に完成、今回の2期工事では、研究開発フロア、アメニティー空間が新たに整備された。

## 小型・軽量の無停電電源装置

### YUASAが2種

YUASAは26日、業界トップクラスの小型・軽量化を実現した無停電電源装置（UPS）「YUMIC—SHA020／030」（写真）2機種を発売した。コンピューター機器などのバックアップ電源用。製品寸法は220×450（530）×500㎜、質量は50㎏以下／60㎏以下と、同社従来品比で70—80%以下にした。価格は出力容量2㌔㍗アワーの製品が50万円、同3㌔㍗アワーの製品が63万円。

## ディスプレー

### 連携強化〝神の声〟

▽…「『グループの連携を強化せよ』という神の声だったのでは」と解釈するのは松下冷機社長の東国広さん。同社が松下電器産業の全額出資子会社になったことへの感想だ。

▽…6月27日に松下電器の電子レンジ事業部長から松下冷機社長兼冷蔵庫事業部長に就任したばかり。「本質的な機能をきっちり満たしながら遊び心も持たせてある」と、9月に発売する音声メモ機能付き冷蔵庫について楽しげに語る。

▽…「家族間の連絡だけでなく『おやじのバカヤロー』なんてメッセージを録音してもいい。使い方次第で遊び心はあふれてくる」と早速、持ち前の明るさを発揮する。〝神の声〟が命じる連携強化の推進役にはうってつけかも。

東さん

## ソニー首脳の会見要旨

参照 1面

ソニーの2000年度第1四半期の決算発表会見での質疑応答は次の通り。

—エレクトロニクス部門が予想以上に好調だが、部品不足の影響は。

安藤 カムコーダーやデジカメ、バイオなどは部品供給の制約によって機会損失が起こっている。携帯電話の世界的な活況が、半導体不足となって、いろいろなところに影響しているのは確かだ。

—メンタムがさらに加速しているようだ。

—生産機能を統合した新会社「ソニーEMCS AV／IT」を来年度に設立する。その狙いは。子会社であるアイワの参加は。

安藤 各カンパニーが統括していた工場を統合することで、トータルとしての最適化が図れる。単なる人減らしではなく、どうやって仕事のプロセスを軽く、そして速くしていけるかが狙い。アイワについては、将来は視野に入れるかもしれないが、今のところ具体的な話はない。

—半導体投資を大幅に増額しているが。

徳中 SCEの新工場であるファブ2への投資が大半を占める。プレイステーション2の早期立ち上げに第一のプライオリティーを置いているが、ファブ2ではソニー本体の製品に対しても半導体を生産する。グループ全体で使うわけだ。

徳中 ただ現地通貨ベースで、第2四半期以降も15%を超える成長は維持できる。特に欧州では成長のモーメンタムがさらに加速しているようだ。

# 液晶製造装置メーカー 大型基板対応機 相次ぎ投入

## 市場規模拡大が追い風

### 液晶メーカーへ 売り込み拍車

液晶製造装置メーカーが相次いで大型基板対応機を市場に投入している。パソコン、液晶テレビ向け大型パネルの需要拡大がその要因だ。ニコン、キヤノンが露光装置で、芝浦メカトロニクス、日立電子エンジニアリングはセル組立装置、アネルバは成膜装置でそれぞれ大型基板対応機を発売した。半導体製造装置の世界シェアで日本製は約3分の1なのに対し、プロセスが似ている液晶製造装置は日本製が少なくとも70—80%と見られ、〝お家芸〟的な分野。国内各社とも液晶メーカーへの売り込みに拍車をかけている。

液晶製造装置の市場規模は半導体製造装置より1ケタ低いが、半導体装置と同様に99年度は前年度に比べ大幅に拡大した。矢野経済研究所のまとめでは、99年度の液晶装置の世界市場の規模は2734億円（前年度比37%増）。2002年度まで拡大が継続し、02年度の世界市場の規模を3847億円と予測。その大きな要因となるのが大型パネルの需要増加だ。

このビジネスチャンスを生かそうと、主要装置メーカーは相次ぎ、大型基板対応装置を製品化している。ニコンは最大ガラス基板800×950㎜に対応した液晶基板用露光装置「FX—21S」を製品化。1回の走査露光により、30㌅ワイド画面のパターンを焼き付けることができる。

これに対し、同じく液晶基板用露光装置を手掛けるキヤノンは、ニコンよりやや大きい880×1000㎜のガラス基板に対応した「MPA—6000」の受注を開始した。こちらは32㌅ワイド画面の一括露光が可能だ。

芝浦メカトロニクスは親会社である東芝の生産技術センターと共同で、900×1100㎜のガラス基板に対応したセル組立装置「CXX—6000」を製品化。この装置はガラス基板を張り合わせる工程に使用される。キヤノンと同様、32㌅ワイドに対応でき、20㌅以上の大型液晶TVが主な用途と見ている。

一方、アネルバ（東京都府中市）は99年に700×900㎜基板に対応した成膜装置を市場投入、さらに1000㎜級装置の製品化を進めている。今村有孝社長は「大型化ニーズはイメージ先行の面もある。本格導入は01年以降になりそう」と予測し、「発売のタイミングが重要」と強調している。

日立電子エンジニアリングは大型ガラス基板対応の重ね合わせ・ギャップ形成システム「AE8000シリーズ」、パターン付き光ガラス基板の異物検査装置「GP2100」を発売。重ね合わせ装置は850×950㎜、検査装置は800×950㎜のガラス基板に対応できる。やはり32㌅ワイドに対応可能だ。

芝浦メカトロニクスのセル組立装置

## エレクトロニクス